

NGP300 无硅导热垫片

产品介绍

无硅导热垫片，长期使用过程中不渗油，特别适用于硅油敏感的应用。并且，无硅导热垫片具有良好的自粘性以及良好的绝缘性、优异的耐老化性、高柔顺性，因此被广泛应用于高灵敏度探头、高清摄像头等高端电子电器行业。

特点

- * 即使在高温下仍具有极佳的导热系数
- * 优异的柔软性、压缩性。
- * 完全不含硅成分
- * 使用经济、方便

应用

- * 移动电子设备
- * 无线通讯硬件产品
- * 微处理器及芯片
- * 笔记本电脑
- * 汽车引擎控制单元

性能

颜色:	灰白色
密度 @ 20°C:	2.9g/cm ³
厚度:	0.3~3.0mm
硬度:	35 (Shore C)

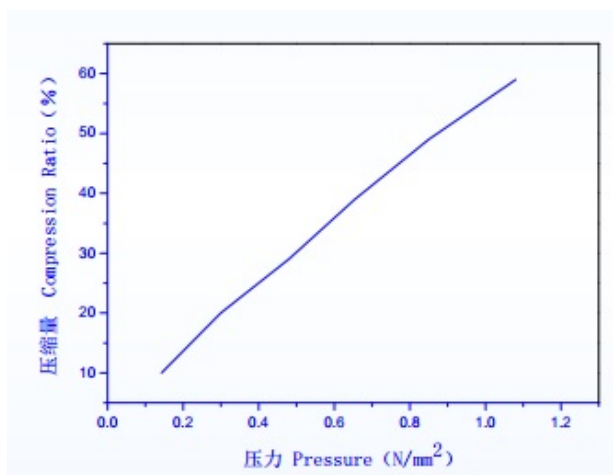
版权所有：Electrolube 2013

给出的所有信息都是真实的，但不作担保。所列性能只作指南，不应作为规范。

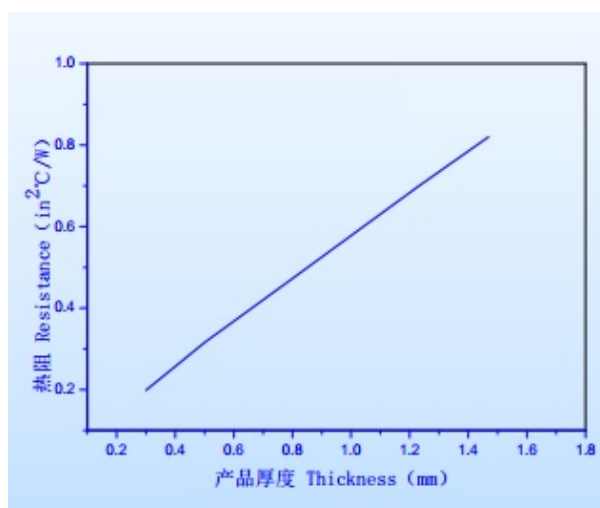
Electrolube 不能保证与用户的施工条件有关的产品性能，为得到最好的性能，用户亦需尽力提供合适的施工条件。

北京市顺义区南彩镇彩园工业区
彩达三街1号茂华工场2号楼
T:8610-89475123
F:8610-89475077
BS EN ISO 9001:2008
Certificate No. FM 32082

初粘性:	5
拉伸强度:	0.173Mpa
断裂伸长率:	240%
温度范围:	-40°C — +150°C
导热系数:	3.0 W/mK
热阻 @20psi&1mm:	0.6(°Cin ² /W)
介电常数 @ 10 ⁶ Hz:	5.0
电阻率:	1 x 10 ⁸ Ohms/cm
绝缘强度:	8 kV/mm
阻燃等级:	UL-94V0



产品压缩率 VS 压力



产品热阻 VS 厚度

包装

200*200mm (可根据客户要求生产、加工各种尺寸、厚度产品)